### 解説

### 光コムによる表面形状計測技術

Surface Profilometry using Optical Frequency Comb

非接触インライン全数検査を目指して

#### 埼玉大学 塩田 達俊

#### 1. はじめに

高い信頼性をもって加工・成型品を製造する 産業界では、物体形状や表面の欠陥の検査技術 に高い性能が求められ、その製造工程や設備、 環境の維持と管理以外に、高性能な検査機器が 必要となる。例えば加工分野では、表面の凹凸 やキズ・ブツなどの欠陥を監視する検査システ ムがあり、これまでも多くの検査方法が開発さ れている。以前は接触式の検査が主流であった 時期もあったが、近年では光を用いた非接触式 の検査装置が主流となり、製造ラインへの導入 も進んでいる。しかし、医療用品や自動車部品 など高速に多数の製品を製造する量産型の製造 ラインでは、全ての製品を検査対象とすること は難しく、抜き取り検査をすることが多い。こ こで、抜き取り検査では不良が発見された際に はそれ以前に製造された製品を一つ一つ調査す るなど膨大なコストを要したり、品質保証の質 を上げることはできないといった問題がある。 そこで、低コストに社会実装できるインライン 全数検査が可能な検査装置の実現が期待されて いる。

加工・成型品の形状検査装置に求められる性 能として、分解能、計測範囲、検査速度、計測 対象の物性や形状の制限などが挙げられる。光 周波数コムは高度に制御された周波数精度を有 し、時間や周波数領域での高い制御性を持つの で、高付加価値な製品や競争力が高い製品を生 むと期待されている。その高いレベルの光周波 数コム(光コム)技術の応用範囲に柔軟性を持 たせるために、筆者は光コムの性能を適当な制 御性に抑えて"いいところ"をとることが重要 と考えている。例えば周波数制御回路を省略し た光コム干渉技術を製造ライン上の製品検査へ 応用することを検討している。

次にその背景を説明する。製品表面のインラ イン全数検査を実現にするためには、検査スピ ードを表す体積サンプリング速度(Voxel/sec) とロバスト性の2点を考慮しなければならな い。ライン上を流れる製品表面の凹凸を検査す るためには、単位時間あたりのサンプリング点 数を多く測定する必要がある。同時に、製造ラ インはそれ自身が振動しているため検査機と製 品の間には絶えず距離変動が生じ、ゆっくりサ ンプリングしていては検査エラーが増える。例 えばある瞬間に物体の1点に照射されたレーザ ー光を空間走査するラスタースキャン法では、 走査中の距離変動が表面形状に重畳され、本来 の表面構造と振動による変位の区別ができなく なる。そのうえ測定点ごとに距離を導出するた めの機器の走査や解析をするための時間の浪費 により、ミリメートルを切るような細かい構造 をインラインで計測することができない。そこ



第1図 筆者が目指す手法と汎用のデジタルカメラの差を 表すイメージ図 提案手法は測定対象を切らずに奥行断面像を取得する。

で、筆者はポイントスキャンから逃れて第1図 のように奥行方向の2次元断層像を、2次元イ メージセンサーを用いて演算なしにシングルシ ョット撮像する研究を進めてきた。製品の不良 検査は2次元断層画像をシングルショットで撮像 できると、忽ちロバスト性が上がり、インライ ン全数検査の実現へ近づける。ただし、せっか く2次元断層をシングルショットで取得して も、シャッタースピードが振動の周期より十分 速くないと、画像にブレが生じて検査の質が低 下する。つまり、ロバスト性を向上するために は、2次元シングルショット断層像を高速なシ ャッタースピードで撮像することが重要であ る。

ここで、既存の非接触式の光形状計測技術を 俯瞰する。近年広角な視野を一度に観察できる カメラを用いた手法が製造現場では急速に普及 拡大している。産業用カメラを応用したマシン ビジョンは、高速に撮像した画像をもとに直ち に合否検査を行って製造ラインにフィードバッ クするシステムとして広く普及している。より 微細な表面形状検査を求める場合には、段差の 上下関係やキズが凹みなのか膨らみなのかを判 定するために、二眼式のカメラや、光切断法 または三角測量法<sup>(1)(2)</sup>が採用される場合が多い。 これらの手法を用いる際には計測原理上物体を 斜め方向から覗くので、死角が生じる欠点を併 せ持つことに注意が必要である。一方で、ミクロ ン以下の分解能を持つ光学顕微鏡は照射光と観 察する光の光学軸を同一にできる利点はあるが、 深さ方向に走査が求められる。

光干涉断層法(OCT:Optical Coherence Tomography)<sup>(3)~(8)</sup>は、サンプルへの入出射光を 同一の光学軸に設計でき、深さ方向にマイクロ メートル領域の分解能を有す。さらに、医療応 用を目指したOCT開発では多数のサンプルを 連続して検査する必要がないため測定時間の高 速化よりも感度向上や検査領域に力が注がれて きた。そのために空間的な検査領域が狭く高速 な体積サンプリング速度での計測は今のとこ ろ実現できていない。例えば、毎秒製品表面 10cm四方にあるミクロン単位のキズを検査し ようとすると、3次元空間を10<sup>11</sup>点(Voxel/s) 以上の速度でサンプリングする必要がある。し かし、エレクトロニクスによる画像情報の伝送・ 処理では、強度情報(10bit程度)を考慮してせ いぜい10<sup>9</sup>Voxel/s程度が限界である。この課題 を克服するために、筆者はマイクロメートル分 解能を持つ光コム干渉の高次干渉信号まで用い ることで、広い深さ範囲をもつ2次元断層像を 高速測定する装置の実現を目指してきた。本稿 では、筆者が開発してきたエタロンで発生する 低コヒーレンス光周波数コム光や疑似的な光周 波数コムである離散光周波数走査レーザー光を 紹介しながら、空間位相変調器(SPM:Spatial Phase Modulator) を組み合わせたシングルショ ット光コム干渉計(9)~(15)で計測範囲を拡大する手 法<sup>14</sup>や、イメージセンサーや光源の設定を最適 化して振動ロバスト性を向上した結果を紹介 する。いずれも時間領域または周波数領域の 低コヒーレンス干渉<sup>66</sup>を空間並列で行い、高速 化と振動ロバスト性の向上を可能にする。ま た、SPMのステップより細かい分解能で表面 位置計測が可能である<sup>155</sup>。

ここで、いずれの手法においてもインライン 全数検査に応用する際には、解析のスループッ トもサンプリング速度以上の速度で行うべきで あることも忘れてはならない。例えば、体積サ ンプリング速度10<sup>9</sup>Voxel/sを得る際に、100万 画素のカメラを用いるとすると、1kfpsで画像 取得する必要がある。ここに、2次元画像を得 るために時間コストがかかる解析プロセスが必 要な計測方法を使用する場合解析の処理速度が データ取得速度より遅くなり、処理データは溜 まり続けることになる。2次元断層画像をでき るだけ演算なく取得できる技術は、全数検査の 実現に極めて要素となる。

OCTに話を戻す。時間領域(TD: Timedomain)<sup>(3)~(5)(15)</sup>または周波数領域(FD: Fourierdomain)<sup>(6)~(8)</sup>のOCTは、雑音に強い。1990年代 から光散乱による強度減衰を伴う生体試料の非 侵襲計測への適用と方向性を一致させ、高感 度化するための研究がされてきた。そのため OCTはプローブ光を1点に集光したラスター スキャンで空間走査する。結局、既存の形態で は機械的または周波数掃引、もしくはデータ取 得後のフーリエ変換等の演算が必要であるため に振動ロバスト性に乏しく、そのままインライ ン全数検査へ展開することは難しい。そこで筆 者らは、敢えて感度を後回しにして2次元断層 像をシングルショットで測定することで、これ まで不可能であった条件でのインライン全数検 査の実現を目指してきた。まず現状の体積サン プリング速度を決めるエレクトロニクスの応答 速度制限を実質的に突破するためにTD法を2 次元シングルショット計測へ拡張し、TD法の 2次元シングルショット計測の実現のためにエ タロンを用いて発生した低コヒーレンス光コム 光を光源とした干渉計を構築して複数次数の干 渉を利用する方式を考案した<sup>100~14</sup>。本稿では、 計測原理を述べたのちに、その原理を実証する 実験結果を紹介する。

# 低コヒーレンス 光コム干渉計測法の原理

2-1 シングルショット2次元断層計測法

光学干渉計の構成として、第2図のように分 波と合波素子を共通の素子とするマイケルソン 干渉計を例に低コヒーレンス干渉を説明する。 ここで、受光器は、分波した二つの光路長差に 依存して、光波の強め合いと弱め合いを干渉と して検出することができる。この干渉の波形は 光源の種類に依存し、可干渉性が低い広帯域 光(低コヒーレンス光)を光源とすれば、干渉 波形が現れる光路長差の範囲は狭くなる(第3 図)。この性質を利用して、分波した2光路の 光路長が等しい、またはそのごく近辺マイクロ



第2図 低コヒーレンス干渉を利用した距離計測の 装置構成



第3図 光源のスペクトルと干渉信号の関係 光源のスペクトル帯域が広いほど距離計測の分解能が高く なる。

メートル以内でのみ干渉して光強度の変動を見 ることができる。つまり、二つの光路の片方を 測りたい物体に照射し、他方を位置が制御され た参照鏡に照射して参照鏡の位置(参照光路長) を走査すれば、参照光路長の位置を根拠にして 測定したい物体の分波器(BS)からの距離を 知ることができる。なお、干渉が生じる領域の 幅は光源スペクトルの周波数帯域に反比例する ので、光源のスペクトル帯域を広げるほど、距 離測定の精度を高くすることができる。

第2図の低コヒーレンス干渉計は参照鏡の位 置を走査することで測定対象物体の位置を計測 するが、参照鏡の位置を時間的に走査する時間 的コストがかかる。シングルショット2次元断 層形状計測法では、参照鏡を空間的に走査する のでその分の時間的コストを抑える。具体的に は、第4図のように参照鏡を傾けてその表面形 状を階段状にすることで、反射位置ごとに異な る遅延時間を光に与えるようにする。ここで、 表面に階段状構造を持ったこのデバイスを空間 位相変調器(SPM)と呼ぶ。SPMに入射した 光は位置ごとに時間が走査されて、測定物体か らの反射光と合波されることで2次元イメージ センサー(CCD)表面で干渉波形が位置情報 として検出される。このとき、SPMにより時 間傾斜を与えた軸方向に沿ったCCD表面上の 1次元方向が測定物体の奥行(z軸)方向とな る。さらに、他方の1次元方向を測定物体の水 平(v軸)方向に充てることで、測定物体の奥 行方向の2次元断層像のイメージングが可能に なる。実験では、第5図のようにレンズ系を工 夫して測定物体表面に線状に光を照射すること



第4図 シングルショット2次元断層計測システムの概要と実際に観測された2次元断層像



第5図 測定物体に照射する光学系 シリンドリカルレンズ (CLB) と球面レンズ (SLB) を組み合わせて測定物体表面に線状に光を照射する。

で、2次元断層像を撮像した。

#### 2-2 低コヒーレンス光コム干渉による 計測範囲の拡大

イメージセンサーを用いて2次元断層像を計 測する際に、測定物体の設置位置に気を付け る必要がある。たとえば、奥行分解能が1µm でイメージセンサーの奥行方向のピクセル数 が1,000であれば、計測レンジは1mmとなる。 このとき、検査される測定物体の表面はその 1mm範囲内に設置しされなければならないが、 インライン検査に適用するに1mmというのは やや狭い。ところが、光周波数コム(光コム) を広帯域光源とすると、物体の設置範囲を10倍 以上に拡大することができる。以下にその原理 を次に述べる。

光源のスペクトルを逆フーリエ変換すると 干渉波形が得られる(ウィナー・キンチンの 定理)。ここで、 $f_{rep}$ をコム間隔、 $f_c$ を中心周波 数、 $\Delta f_{band}$ を光周波数コムスペクトルの半値幅、  $F(f-f_c)$ を包絡線、G(f)をコムスペクトル の縦モードの形状としよう(第6図)。このとき、 光周波数コムによって得られる干渉信号 $\Gamma(c\tau)$ は次のように表される<sup>16</sup>。

$$\Gamma(c\tau) = IFT \left[ F\left(\frac{f-f_c}{c}\right) \cdot \left\{ G\left(\frac{f}{c}\right) * \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta\left(\frac{f-pf_{rep}}{c}\right) \right\} \right]$$
$$\approx c \cdot g(c\tau) e^{i2\pi f_c c\tau} \left\{ f(c\tau) * \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta\left(c\tau - p\frac{c}{f_{rep}}\right) \right\}$$
$$\cdots (1)$$

ここで、*IFT*[…] は逆フーリエ変換、cは光速 を表し、 $f(c\tau)$ 、 $g(c\tau)$  はF(f/c)、G(f/c)を逆フーリエ変換した関数である。

その干渉信号は時間軸上で光周波数コムと同様に周期的に干渉ピークが現れる。干渉ピークの光路差はc/frepと表すことができる。これにより、2次元断層像がイメージセンサーからフレームアウトしても、次の干渉次数(p)による同様の画像が出現するようになる。つまり測定物体の設置位置の範囲が実質的に広がり、イメージセンサーのピクセル数に制限を受けなくなる。

実際の応用を考えると、光コムを光源として 干渉計に応用する場合、レーザーコムは高価な ため、広帯域光源の出力側に光共振器を設置す る形式がよいと思われる。光共振器はガラス板 の両面に金属蒸着するなどすれば研究室でも簡 単に製作できる。光源は市販のLEDのように 入手しやすい安価なものでも計測は可能であ る。もしより高感度な計測実験をしたければ、 スーパーコンティニューム光を光源に用いると よい(第7図)。

#### 3. 応用実験

#### 3-1 干渉次数の判別と計測範囲の拡大

第7図のように、光源を①のSLD (Super luminescent diode) として直後にエタロンを 配置した構成で、サンプルの位置を光軸方向に



第6図 (a) 光コム光源のスペクトルと(b) 干渉出力の距離依存性の関係



第7図 2次元シングルショット断層計測装置の概要と実際に観測された2次元断層像



第8図 (a)繰返し現れる高次干渉と(b)干渉次数を判別し 計測レンジを拡大した結果

徐々に変化させて干渉が現れる奥行方向の位置 をプロットすると第8図が得られた。干渉波形 がカメラからフレームアウトしても異なる次数 が得られることがわかる<sup>(11)(4)</sup>。この時、エタロ ンの入射角を少し変えて、つまりコム間隔を変 えて干渉の位置の変化量をみればその干渉の干 渉次数を知ることができる。つまり次数判別す ることができる。これを利用して第8図(b)では 少なくとも計測範囲を30倍に拡大できることを 示している。これは、画素数10<sup>6</sup>pix/frame、フ レームレート10<sup>3</sup>frame/sec、強度分解能12bit のイメージセンサーを用いた場合に、実質数 10<sup>11</sup>bit/secの体積サンプリング速度を達成した ことを意味する。ところでコム間隔を変える方 式として、エタロンの内部にネマティック液晶を 注入し電気的に制御する方式も提案している<sup>220</sup>。

## 3-2 離散波長可変レーザー(疑似コム干渉)

前項までに光コム干渉の単一の干渉次数で 撮像されるシングルショット計測範囲を500 µm 前後に設定して10mm程度へ範囲拡大を実証し た。ここで次数あたりの計測範囲500 µmを与 える光コム間隔は200GHz程度であり、これを レーザーコムで発振させることは容易ではな



**第9**図 離散光周波数可変レーザーの構成概要と発振スペクトル(上のスペクトル) 光源の平均出力が同じ場合には、広帯域光源とエタロンの組み合わせでは問題となる損失の影響を受けず高出力な光源となる。

い。そこで、前項では低コヒーレンス光コム光 を広帯域光から光フィルタ(ミラー間隔約500 u mのエタロン)で抜き出す構成を紹介した。こ こでは光源による検出感度の最適化を目指し て、第9図のようにエタロンと、ポリゴンミラ ーと回折格子を有す光周波数走査部をレーザー 共振器内に設置してエネルギー利用効率の向上 を目指した結果を示す。外部共振器型のリング レーザーとエタロンを組み合わせて周波数ステ ップ200GHzで30nmの帯域を42kHzの繰返し周 波数で離散的に光周波数が走査されることと、 2次元シングルショット距離計測に適用できる ことを実験的に確認した<sup>14</sup>。光源の光パワーの 比較としては、第9図の通り前項の方式に比べ て10dB以上エネルギー利用効率が向上するこ とを確認できた。

#### 3-3 表面検査の原理確認実験

耐振動としてのロバスト性を検証するため に、測定物体を鏡として鏡をピエゾ素子に設置 して、鏡面鉛直方向に100Hzの振動数で振動を 印加した。その際の振動の振幅は大よそ100 µm であった。シャッタースピードを変えて1ms毎



第10図 振動ロバスト性の検証結果(100Hz) カメラのシャッタースピードを上げるほど常に鮮明に撮像 される様子がわかる。

に撮像した断面画像を第10図に示す。シャッタ ースピードが遅いほど、線状に移る鏡面の断層 像がボケる様子が見て取れる。ピエゾ素子には 正弦波を印加しているため、正弦波の腹付近(経 過時間2ms前後)では表面の移動速度が高速で あるため顕著にボケが観測されると考えられ る。しかし、シャッタースピードが1µsではい ずれの経過時間においても鮮明に鏡面画像が撮 像されている様子がわかる。つまり、シングル ショット2次元断層計測システムのシャッター



第11図 100 µmの段差が表面にある試料の表面形状

スピードを高速にすることで、ロバスト性が向 上することを示している。製造ライン上の振動 成分は最高で100Hz台であるため、シャッター スピードを1μsまたはサブμs程度に設定する ことで、実用に耐える振動のロバスト性が得ら れる。

さらに表面に構造を有するサンプルへの適用 性を調査するために、第11図(a)のような表面に 段差100μmを持った物体を測定した。その測 定結果を第11図(b)に示す。干渉の線幅から分解 能は1~2μm程度だった。シングルショット2 次元断層像と直交した方向にサンプルを走査し て測定した複数の画像を示している。さらに、 これらの結果を元に3次元画像を構成した結果 が第11図(c)である。3次元画像内に100μmの 明らかな段差が見られる。また、十円硬貨の測 定結果から(第12図)、複雑な表面構造の計測 も可能であることがわかる。

最後に断層計測への適用性を調べるために、 第13図のように100 μm台の薄板ガラスを、空



第12図 十円硬貨の表面形状を測定した結果



第13図 積層薄板ガラス(各層150 µm程度)



第14図 測定した積層薄板ガラスの断層像

気層を介して3枚積層した多層膜試料を測定した。その結果、第14図のように各薄板ガラスの 表面と裏面に相当する6界面の断層像が観測された。光が侵入する透明物体であれば、塗装のような多層膜の構造検査を非接触に行えること が分かる。

#### 3-4 分解能の追及

干渉波形の奥行方向の1次元の断面波形を抜 き出してピーク検出することで実験的に分解能 を導出することを試みた。測定対象を平面鏡と してその表面の位置を奥行方向に20nmステッ プで走査し100枚の2次元断層像を取得した。 取得画像から表面位置に相当するピーク位置を 導出して、走査距離に対してプロットした結果 を第15図に示す。



与えた位置に対して測定された結果は比例 し、そのフィッティング結果との間隔の標準偏 差は26.4nmとなった。SPMが持つ離散的な段 差(494nm)の18分の1の精度であり、走査ス テップとほぼ同じ値となった。つまり、提案し た2次元シングルショット断層計測法の奥行方 向の分解能はSPMの離散的高さにより制限さ れず、ナノメートルの検出精度を実現できるこ とが実験的に確認された。

#### <参考文献>

- V.Bodlaj and E.Klement, "Remote measurement of distance and thickness using a deflected laser beam". Appl. Opt., Vol.15, No.6, pp.1432-1436 (1976)
- (2) M. Rioux, "Laser range finder based on synchronized scanners", Appl. Opt., Vol.23, No.21, pp.3837-3844 (1984)
- (3) L.Deck and P.de Groot, "High-speed noncontact profiler based on scanning white-light interferometry", Appl. Opt., Vol.33, No.31, pp.7334-7338 (1994)
- (4) E.A.Swanson, D.Huang, M.R.Hee, J.G.Fujimoto, C.P.Lin and C.A.Puliafito, "High-speed optical coherence domain reflectometry", Opt. Lett., Vol.17, No.2, pp.151-153 (1992)
- (5) M.D.Duncan, M.Bashkansky and J.Reintjes, "Subsurface defect detection in materials using optical coherence tomography", Opt. Express, Vol.2, No.13, pp.540-545 (1998)
- (6) RLeitgeb, M.Wojtkowski, A.Kowalczyk, C.K.Hitzenberger, M.Sticker and A.F.Fercher, "Spectral measurement of absorption by spectroscopic frequency-domain optical coherence tomography", Opt. Lett., Vol.25, No.11, pp.820-822 (2000)
- (7) S.R.Chinn, E.A.Swanson and J.G.Fujimoto, "Optical coherence tomography using a frequency-tunable optical source", Opt. Lett., Vol.22, No.5, pp.340-342 (1997)
- (8) R.Huber, M.Wojtkowski and J.G.Fujimoto, "Fourier Domain Mode Locking (FDML) : A new laser operating regime and applications for optical coherence tomography", Opt. Express, Vol.14, No.8, pp.3225-3237 (2006)
- (9) T.Shioda, T.Morisaki, H.Ono, "Single-shot tomography by means of VIPA and spatial phase modulator installed optical interferometer", Opt. Commun., Vol.284, pp.144-147 (2011)
- (10) T.Shioda, T.Morisaki, T.Q.Banh and K.Suzuki, "Twodimensional single-shot tomography using a virtually imaged phased array and a spatial phase modulator", Appl. Opt., Vol.51, No.21, pp.5224-5230 (2012)
- (11) T.Q.Banh, K.Suzuki and T.Shioda, "Development of an incoherent optical frequency comb interferometer for long-range and scanless profilometry and tomography", Opt. Commun., Vol.296, pp.1-8 (2013)
- (12) T.Q.Banh, K.Suzuki, M.Kimura and T.Shioda, "Twodimensional high-speed and long-range tomography and profilometry using liquid-crystal Fabry-Perot resonator", Appl. Opt. Vol.54, No.4, pp.912-918 (2015)
- (13) 塩田達俊: "インライン全数検査を目指す非接触光表 面形状計測システム"、クリーンテクノロジー、Vol.31、 No.3、pp.45-50 (2021)
- (14) T.C.Truong, T.Q.Banh, H.Kim and T.Shioda, "Axial zoomable 2D single-shot comb interferometry using spatial phase modulator for profilometry and tomography", Opt. Commun., Vol.349, pp.276-283 (2019)

- (15) B.D.Thai, K.Chiba, T.T.Cong and T.Shioda, "Nanometer resolution of 2D single-shot low-coherence & comb-based profilometry based on the effect of discrete height of spatial phase modulator surface", Opt. Commun., Vol.546, 129802 (2023)
- (16) D.Huang, E.A.Swanson, C.P.Lin, J.S.Schuman, W.G.Stinson, W.Chang, M.R.Hee, T.Flotte, K.Gregory, C.A.Puliafito and J.G.Fujimoto, "Optical Coherence Tomography", Science, Vol.254, No.5035, pp.1178-1181 (1991)
- (17) S.Choi, M.Yamamoto, D.Moteki, T.Shioda, Y.Tanaka and T.Kurokawa, "Frequency-comb-based interferometer for profilometry and tomography", Opt. Lett., Vol.31, No.13, pp.1976-1978 (2006)
- (18) T.Awane, T.Q.Banh and T.Shioda, "High-speed 2D Single-shot Surface Profilometry for Industrial Inspection

under Vibrational Environment", OSA Laser Congress, LM4B (2019)

